



JZ_RF 芯片选型表

芯片类型	型号	封装	调制方式	频率范围	供电电压 (V)	应用范围
单发射 配合 MCU 用	JZCT05	SOT23-6	OOK	240-480MHz	1.8-3.6	出口或国内 315
	JZCT05B	SOT23-6	OOK	240-480MHz	1.8-3.6	出口或国内 315
	JZCT05H	SOT23-6	OOK	240-960MHz	1.8-3.6	出口或国内高频段应用
	JZCT06	SOT23-6	OOK/FSK	240-960MHz	1.8-3.6	仅支持直通模式
	JZCT07	QFN16	OOK/FSK	127-1020MHz	1.8-3.6	支持直通和 FIFO 数据包结构模式
	JZET13	SOT23-6	OOK	300-450MHz	2.0-5.5	433 出口或国内低成本应用
	JZET14	SOT23-6	OOK	300-450MHz	2.0-5.5	433 出口或国内低成本应用
	JZET15	SOT23-6	OOK	300-450MHz	2.2-5.5	433 出口或国内低成本应用
编码发射	JZ1527	SOP8	OOK	315-433MHz	2.2-13	国内声表应用, 替代 1527
	JZCT03L	SOP8	OOK	240-480MHz	1.8-3.6	中高端, 集成 1527 等编码
	JZCT03	SOP14	OOK	240-480MHz	1.8-3.6	中高端, 集成 1527 等编码
	JZCT03H	SOP14	OOK	240-960MHz	1.8-3.6	中高端, 自定义编码
	JZDT08	SOP8	OOK	433MHz	1.8-3.6	低端, 对成本要求较高
SoC 发射	JZAT01	SOP8	OOK	300-450MHz	2.2-5.5	433 出口或国内低成本应用
	JZAT02	SOP16	OOK	300-450MHz	2.2-5.5	433 出口或国内低成本应用
接收芯片	JZCR04	SOP8	OOK	300-480MHz	3.0-5.5	低端, 531 脚位
	JZCR05	SOP16	OOK	300-480MHz	1.8-3.6	KC 认证产品
	JZCR07	SOP8	OOK	300-480MHz	3.0-5.5	低端, 480 脚位
	JZCR08	SOP8	OOK	315-433MHz	1.8-3.6	中高端, 对成本要求不高
	JZCR10	SOP8	OOK	300-480MHz	2.0-5.5	中高端, 对成本要求不高
	JZCR11	SOP8	OOK	300-480MHz	1.8-3.6	中高端, 对成本要求不高



	JZCR12	SOP8	OOK	300-920MHz	1.8-5.0	中高端, 高频段应用
	JZCR14	QFN16	OOK/FSK	300-960MHz	1.8-3.6	高端, 支持烧录和软件配置
	JZCR15	QFN16	FSK	127-1020MHz	1.8-3.6	高端, 仅支持烧录
	JZCR16	QFN16	OOK/FSK	127-1020MHz	1.8-3.6	高端, 支持 FIFO 或直通
	JZER19	SOP8	OOK	300-440MHz	3.0-5.5	中低端, 非电池供电, 531 脚位
	JZER20	SOP8	OOK	300-450MHz	3.0-5.5	中低端, 非电池供电, 480 脚位
	JZFR21	SOP8	OOK	300-450MHz	2.0-5	中低端, 电池供电, 531 脚位
	JZFR22	SOP8	OOK	300-450MHz	2.0-5	中低端, 电池供电, 480 脚位
	JZFR23	SOP16	OOK	300-450MHz	2.5-5.5	中高端, 强抗干扰应用
	JZFR24	SSOP16	OOK	300-450MHz	2.5-5.5	中高端, 强抗干扰应用
收发芯片	JZRT101	QFN16	OOK/FSK	127-1020MHz	1.8-3.6	高端, Sub-1Gs 双向应用
	JZRT201	SOP8	FSK	2400-2483	2.3-3.6	双向 2.4G 单芯片
	JZRT202	SOP16	FSK	2400-2483	2.3-3.6	双向 2.4G-SoC 芯片, 4K
	JZRT203	SOP16	FSK	2400-2483	2.2-3.6	双向 2.4G-SoC 芯片, 2K
	JZRT204	SOP16	FSK	2400-2483	2.2-3.6	SoC 芯片, 2K, EEPROM
	JZRT301	SOT23-6	FSK	2400-2483	2.2-3.6	双向 2.4G 单芯片
	JZRT302	SOP8	FSK	2400-2483	2.2-3.6	SoC 芯片, 1K



JZ_RF 收发模块

模块规格	型号	调制方式	频率范围 (MHz)	工作电压 (V)	灵敏度 (dBm)	省电模式	尺寸 (mm)	特点	状态
发射模块	JZ_TX03	OOK	315/433.92	2.0~5.5	-	有	11.5*1	●射频参数可烧写 (TX04) ●价格低廉/省电	在产 主推
	JZ_TX04	OOK	315/433.92	1.8~3.6	-	有	12*16*1.0	●工作稳定可靠 ●需配合单片机或无线编码芯片使用	在产 主推
超外差接收模块	JZ_RXB01	OOK	315/433.92	3~5.5	-109	无	14*16*1.0	●灵敏度高价格低 ●工作稳定可靠 ●低功耗 ●需配合单片机 ●IC=JZER18/JZER20	在产 主推
	JZ_RXB05	OOK	315/433.92	3~5.5	-109	无	27.5*8.5*1.0	●灵敏度高价格低 ●工作稳定可靠 ●需配合单片机用 ●IC=JZER19	在产 主推
超外差带解码接收模块	JZ_RXD01	OOK	315/433.92	1.8~5.5	-114	有	22.5*16*1.0	●非遥控功能的产品增加遥控功能,应用方便 ●原来用 2272 的产品用此模块成本更低,生产更方便,学习功能可选 ●功能复杂、不方便和主控芯片一起解码的产品,使用方便 ●需要低功耗的产品,自带单片机,静态功耗低于 1uA、工作功耗 1mA 以内	在产 主推
2.4G收发模块	JZ_RTX01	GFSK	2400~2483	2.3~3.3	TX: 10 RX: -96	有	14*17.6*1.0	●支持跳频 ●支持 3 线 SPI 接口 ●内置 auto_ack 功能	在产
	JZ_RTX02	GFSK	2400~2483	2.3~3.3	TX: 10 RX: -96	有	16.5*128*1.0	●支持跳频、 ●支持 4 线 SPI 接口 ●内置 auto_ack 功能	在产



	型号	产品描述	温度	FLASH	尺寸 (mm)	天线类型
蓝牙系列	TYBT1	兼容 BLE4.0, 由高集成度的蓝牙芯片 TLSR8266 和少量的外围电路构成, 内置蓝牙网络通信协议栈	-20 - +85°C	512K	15×17.3×3	内置 PCB 板载天线
	TYBT3	兼容 BLE4.2, 由高集成度的蓝牙芯片 TLSR8267 和少量的外围电路构成, 内置蓝牙网络通信协议栈	-20 - +125°C	512K	15×16.5×3	内置 PCB 板载天线
	HM-BT4501	基于 CMT4501 低功耗蓝牙芯片实现的无线数据透传模块, MUC 资源占用低, 开发简单	-40 - +125°C	-	17×12.5×2	内置 PCB 板载天线
NB-IoT 系列	SZ10-NB-IoT	符合 LTE 制式 NB-IoT 窄带通讯标准, 具有覆盖广、连接多、速率低等特点	-40 - +85°C	-	152×66×36	外置天线
	HPM152	支持频段 B5, B8; WAKEUP_IN & WAKEUP_OUT	-40 - +85°C	-	17.6×15.9×2.3	外置天线
LoRa 系列	RFM95/96/97/98	属 LoRaTM 远程通信模块, 提供超长距离扩频通信及拥有超强抗干扰性并且电流功耗超低	-40 - +85°C	-	16×16	外置天线



物联模块-Wi-Fi 模块

型号	产品描述	温度	FLASH	尺寸 (mm)	天线类型
WROOM-02D	SMD 模组, 集成 ESP8266EX, 2MB SPI flash, 支持 UART Mode	-40 - +85°C	2MB	18×20×3.2	内置 PCB 板载天线
WROOM-02U	SMD 模组, 集成 ESP8266EX, 2MB SPI flash, 支持 UART Mode	-40 - +85°C	2MB	18×14.3×3.2	外置 IPEX 天线
WR2	直插模组, 集成 RTL8710BN, 2MB SPI flash, 支持 UART Mode	-20 - +85°C	2MB	16×24×3.5	内置 PCB 板载天线
WR3	SMD 模组, 集成 RTL8710BN, 2MB SPI flash, 支持 UART Mode	-20 - +85°C	2MB	15.5×13.8×3.5	内置 PCB 板载天线
LPB130	SMT34 模组, 集成 RDA5981A, 2MB SPI flash, 支持 UART Mode	-40 - +85°C	1M/2MB	23.1×32.8×3.5	内置 PCB 板载天线或 外置 IPEX 天线
LPT230	SMT18 模组, 集成 RDA5981A, 2MB SPI flash, 支持 UART Mode	-40 - +85°C	1M/2MB	22×13.5×3	内置 PCB 板载天线或 外置 IPEX 天线

Wi-Fi
模块



物联模块-Zigbee 模块

Zigbee 模块	型号	产品描述	温度	FLASH	尺寸 (mm)	天线类型
	REX3B	符合 ZigBee3.0 协议标准, 支持自我修复、自我组织的网状网络	-40 - +85°C	256K	20.4×14.8×1.8	内置 PCB 板载天线
	REX3L	LED 照明专用模块, 支持 RexBee 和 ZLL 通信协议, 有专用固件	-40 - +125°C	512K	20.4×14.8×1.8	内置 PCB 板载天线
	SZ05-L-STD-3	模块采用 TI 的芯片, 符合 ZigBee pro 国际规范, 实现 TTL 串口数据的透明传输	-40 - +85°C	-	22×17×2.8	内置 PCB 板载天线或外置 IPEX 天线
	SZ05-L-PRO-5	基于 Silicon Labs Ember 芯片方案, 符合 ZigBee 国际规范的射频模块	-40 - +85°C	-	22×17×2.8	内置 PCB 板载天线或外置 IPEX 天线
	TYZS2	基于 silicon labs 芯片方案, 贴片焊接或插针免焊接, 支持 UART	-40 - +85°C	-	14.8×20.4×3.0	内置 PCB 板载天线或外置 IPEX 天线
	TYZS3	基于高集成度的无线射频处理器芯片 EFR32MG13P732 和少量外围器件构成	-40 - +85°C	512K	16×24×3.5	内置 PCB 板载天线或外置 IPEX 天线